

# 정밀화학·생명공학 기술유출 많다!

NISC, 2007-2011년 전체의 12% 달해 ... 전기전자가 37%로 최대

정밀화학 분야의 기술유출이 전체 기술유출 사례의 9%에 해당하는 것으로 나타났다.

국가정보원 산업기밀보호센터(NISC)의 기술유출 통계에 따르면, 2007-2011년 5년 동안 국내에서 발생한 산업스파이 사건을 분석한 결과 총 204건의 기술유출 사례가 적발됐으며 61%인 125건이 개인영리 때문에 기술을 빼돌린 것으로 파악됐다.

이어 직접적인 금전유혹이 20%로 41건에 해당했으며, 인사불만이 8%로 16건, 처우불만이 6%로 13건을 차지했다.

기술유출을 감행한 주체는 전직 직원이 62%로 가장 많고 현직직원 17%, 협력기업 13%, 기술 관련 과학자 2%, 관련 투자기업 1% 순으로 조사됐다.

전기전자가 37%로 기술유출 사례가 가장 많았고 이어 정밀기계 27%, 정보통신 15%, 정밀화학 9%, 생명공학 3% 순으로 나타났다.

기술유출 유형은 USB나 외장하드에 빼돌리는 형태 등을 말하는 무단보관이 42%, 내부공모 25%, 매수 23%, 공동연구 2%, 위장합작 1% 순이었다.

최근 주요 기술유출 사례는 첨단 디스플레이 기술 중국 유출, 중국인 연구원의 가전기술 해외유출 기도, 국내 3D 기술 중국 유출, 양문형 냉장고 설계기술 중국 유출기도 등 주로 중국으로 기술을 빼돌리거나 유출을 시도한 사례가 많은 것으로 나타났다.

이외에 자동차 핵심 제조기술의 러시아 유출과 신호소자 반도체 공정기술의 타이완 유출, 태양광 차단 신소재 기술의 일본 유출 사례도 있는 것으로 조사됐다.

2012년 5월에는 국가 R&D 자금 수십억원이 투입돼 개발된 선박부품 설계기술을 모기업 퇴직간부 등이 외장하드에 담아 빼낸 뒤 동종기업을 설립하고 중국에 불법 유출하려다 적발된 것으로 알려졌다.

산업기밀보호센터는 “산업스파이 사건은 단발성 범죄로 증거 확보와 추적이 곤란하고 이메일 복사 등으로 유출돼 피해사실을 인지하기 어려운 사례가 많다”고 말했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2013/04/29>